



Pressemitteilung

11. Internationaler Kongress Molded Interconnect Devices

Kongresszentrum Fürth
Metropolregion Nürnberg
24.-26. September 2014

Forschungsvereinigung
Räumliche
Elektronische Baugruppen
3-D MID e.V.

Fürther Straße 246b
90429 Nürnberg

Telefon: +49 911 5302-9100
Telefax: +49 911 5302-9102

24. September 2014

Internationaler Kongress MID 2014 – Schwerpunkt und Plattform für internationale Mechatronikforschung

Serienprodukte stimulieren Folgeprojekte – Innovative Anwendungen für Medizintechnik, Telekommunikation und Automobilindustrie – Internationale Beteiligung stärkt Technologietransfer

Mit mehr als 260 Teilnehmern aus insgesamt 15 Ländern hat der 11. internationale Kongress zur MID-Technik in Fürth wiederum nachhaltige Impulse zur Förderung der innovativen Technologie räumlich integrierter elektronischer Baugruppen gesetzt. Die diesjährige Tagung stand vor allem unter dem Eindruck zahlreicher Serienanwendungen – Beleg für die starke Verbreitung der MID-Technologie in verschiedensten Produktbereichen. Mit insgesamt 42 Fachvorträgen, einer begleitenden Industrieausstellung und ergänzenden Besichtigungen von führenden Forschungsinstituten bot sich den Teilnehmern eine breite Informationsmöglichkeit zu den alternativen Herstellungsverfahren und den Integrationspotenzialen der Technologie MID.

Die Technologie mechatronisch integrierter Schaltungsträger (MID – Molded Interconnect Devices) ermöglicht die direkte Verbindung von mechanischen, elektrischen/ elektronischen, thermischen, fluidischen und optischen Funktionen auf dreidimensionalen Substraten. Damit gehen vielfältige Vorteile der Miniaturisierung, erhöhter Gestaltungsfreiheit und verkürzter Prozessketten einher. Bei der Eröffnung der Konferenz erläuterte der Vorsitzende der Forschungsvereinigung, Prof. Jörg Franke, die Möglichkeiten und Potenziale einer Kombination generativer Fertigungstechnologien wie der Stereolithographie, dem Fused Deposition Modeling oder diverser 3D-Druckverfahren mit 3D-MID-Technologien.

Herr Dr. Martin Giersbeck, Leiter der Abteilung für Kunststofftechnik der Robert Bosch GmbH in Waiblingen, beleuchtete in seinem Leitvortrag das immense Potenzial der Kunststofftechnik für innovative mechatronische Produkte aus der Perspektive eines Global Players der Automobilindustrie. Hierbei ging er detailliert auf Vorzüge und Grenzen verschiedener, werkzeugunabhängiger MID-Herstellungsverfahren wie der Laserdirektstrukturierung, der Jetting- sowie der Plasma-Technologie ein. Um das große Potenzial der MID-Technologie in einem weiteren Einsatzfeld nutzen zu können, seien als Schlüsselfaktoren in Forschungs- und Entwicklungsarbei-

1. Vorsitzender: Prof. Dr. J. Franke
stv. Vorsitzender: A. Birkicht, Dr. A. Pojtinger
Geschäftsleitung: T. Kuhn, R. Wasilewski-Becker
USt.-ID-Nr.: DE 157 398 719

Bankverbindung:
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE21 76350000 00000 79354
Swift/BIC: BYLADE M1 ERH

 Mitglied

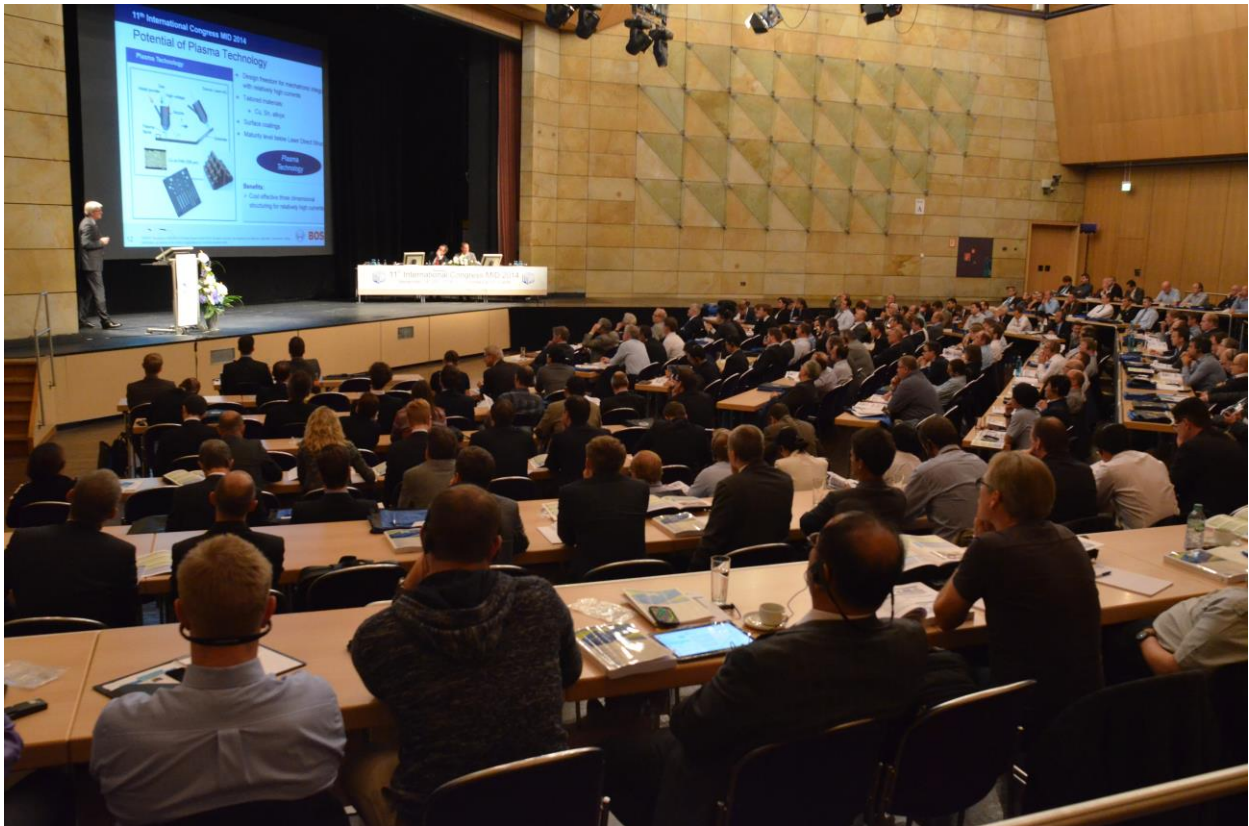
ten insbesondere die vier Bereiche Materialien, Prozesse, Aufbau- und Verbindungstechniken sowie übergreifend das Thema Zuverlässigkeit zu fokussieren.

Insgesamt wurde von den Referenten in den weiteren Fachvorträgen, ein umfassender Überblick zur MID-Technologie gegeben. Dabei wurden den Teilnehmern die thematischen Schwerpunkte in parallelen, zielgruppenorientierten Vortragsblöcken aus industrieller wie auch aus wissenschaftlicher Perspektive vorgestellt. Darüber hinaus informierten Repräsentanten der MID-Schwerpunktregionen in einer speziellen Session mit dem Titel "MID International" in einem globalen Vergleich über die jeweilige lokale Marktsituation mit den wesentlichen Anwendungsfeldern und Hauptakteuren sowie über die technologischen Entwicklungen und Trends.

Die Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. hat mit dieser erfolgreichen Konferenz auch ihr übergreifendes Anliegen vermittelt, neben einer sehr intensiven Gemeinschaftsforschung durch wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit die Potenziale der MID-Technik im Umfeld der Elektronikindustrie aufzuzeigen und zu neuen Anwendungen anzuregen. Derzeit gehören der Forschungsvereinigung insgesamt 95 Firmen und Institute an, die sowohl Großunternehmen als auch die Breite des Mittelstands repräsentieren und technologisch alle Fachbereiche abdecken. Des Weiteren ist mit der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) und den internationalen Kooperationen die fachliche Vernetzung zu benachbarten Industriegruppen gegeben. Die Veranstaltung hat auch die Region Nürnberg-Fürth erneut als wichtige Plattform für Entwicklung und Technologietransfer erwiesen.

Im internationalen Vergleich wird immer wieder der besondere Vorteil für Europa und Deutschland angesprochen, der sich durch die intensive Kooperation von Industrie und vielfältigen Forschungseinrichtungen ergibt. In diesem Sinne verleiht die Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. Förderpreise an ausgezeichnete Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten, die mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit besondere Impulse zur MID-Technik gesetzt haben. Diesmal wurde der MID-Förderpreis an Dipl.-Wirtsch.-Ing. Klaus Schütz für seine exzellente Abschlussarbeit zum Thema Selektives Lichtsintern für gedruckte Elektronik vergeben.

Der nächste, 12. Internationale Kongress MID 2016 findet im September 2016 wieder in der Metropolregion Nürnberg statt.



Der 11. Internationale Kongress MID 2014 setzt erneut nachhaltige Impulse zur Förderung der innovativen Technologie räumlich integrierter elektronischer Baugruppen.

Text und Bild können Sie auch elektronisch abrufen unter: www.3dmid.de

Kontakt:

Forschungsvereinigung 3-D MID e.V.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Thomas Kuhn
Fürther Straße 246b, D-90429 Nürnberg
Telefon: +49 911 5302 9101
Telefax: +49 911 5302 9102
E-Mail: kuhn@3dmid.de

1. Vorsitzender: Prof. Dr. J. Franke
stv. Vorsitzender: A. Birkicht, Dr. A. Pojtinger
Geschäftsleitung: T. Kuhn, R. Wasilewski-Becker
USt.-ID-Nr.: DE 157 398 719

Bankverbindung:
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE21 76350000 00000 79354
Swift/BIC: BYLADE M1 ERH

 **AR** Mitglied